



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042020-218992  
CG-DL-E-01042020-218992

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85]  
No. 85]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2020/चैत्र 12, 1942  
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2020/CHAITRA 12, 1942

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(आईपीएचडब्ल्यू प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2020

विषय: इलेक्ट्रॉनिक संघटकों और अर्धचालकों के विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए योजना (एसपीईसीएस)

## 1. पृष्ठभूमि

सं. W-18/30/2019 -आईपीएचडब्ल्यू- एमईआईटीवाई.—1.1 सरकार इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर विनिर्माण को उच्च प्राथमिकता देती है क्योंकि यह भारत सरकार के "मेक इन इंडिया" और "डिजिटल इंडिया" कार्यक्रम दोनों के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। भारत में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण उद्योग वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं के साथ-साथ मूल्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों की तुलना में 8-10% की अक्षमता का सामना करता है।

1.2 घरेलू इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण में पिछले कुछ वर्षों में काफी वृद्धि हुई है और सेमी नॉक डाउन (एसकेडी) कम्प्लीटली नॉक डाउन (सीकेडी) विनिर्माण स्तर की ओर स्थिरतापूर्वक बढ़ रहा है। हालांकि, घरेलू मूल्य प्रोत्साहन केवल 10 - 30% की सीमा में लगातार कम हो रहा है। यह इलेक्ट्रॉनिकी उपकरणों की विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र की कमी, अर्धचालक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के अभाव और देश में प्रदर्शन विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र की अनुपस्थिति के कारण है। घरेलू इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण की प्रमुख वृद्धि आयातित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों/उप-असेंबली/संघटकों, मुख्य रूप से घरेलू मांग का संचयन करते हुए तैयार उत्पादों के समोजन के कारण हुई है।

1.3 उच्च घरेलू मूल्य प्रोत्साहन के साथ इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण के लिए आपूर्ति श्रृंखला का विकास आवश्यक है। 25.02.2019 को अधिसूचित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति 2019 (एनपीई 2019) की दृष्टि में, भारत को इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थान देने है जिसमें चिपसेट सहित मुख्य घटकों को विकसित करने के लिए देश में क्षमताओं को प्रोत्साहित और प्रबल करना और उद्योग के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक सक्षम वातावरण तैयार करना है।

1.4 इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अर्धचालक का विनिर्माण पूंजी प्रधान है और इसे लगातार बदलती प्रौद्योगिकी से निपटना चाहिए। घटक इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के केंद्र में हैं और बिल ऑफ मटेरियल (बीओएम) के कुल मूल्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के समग्र दीर्घकालिक और सतत विकास और भुगतान के निवल सकारात्मक भुगतान देय (बीओपी) को प्राप्त करने के लिए एक जीवंत इलेक्ट्रॉनिक संघटक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र महत्वपूर्ण है।

1.5 इलेक्ट्रॉनिक संघटनों/अर्धचालकों के निर्माण के लिए निवेश आकर्षित करने के तरीके में मुख्य बाधाएं "शून्य" बेसिक सीमा शुल्क (बीसीडी) में आयात शामिल हैं क्योंकि अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक घटक/अर्धचालक सूचना प्रौद्योगिकी समझौते विश्व व्यापार संगठन के (आईटीए -1) की प्रतिस्पर्धी होने के लिए वैश्विक स्तर की क्षमता स्थापित करने के लिए पूंजी की उच्च लागत; अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा; प्रतिस्पर्धी दरों पर पर्याप्त, विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण बिजली की उपलब्धता के साथ-साथ पानी की आपूर्ति की कमी; आपूर्ति श्रृंखला की कमी; उच्च रसद लागत; तकनीक आदि की कमी के तहत आते हैं।

1.6 संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-सिप्स) को असमर्थता और उच्च अग्रिम लागत की भरपाई करने में मदद करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु एक योजना के रूप में डिजाइन किया गया था और जिससे इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित हुआ। यह योजना नई परियोजनाओं के साथ-साथ विस्तार परियोजनाओं के लिए 31.12.2018 तक आवेदन प्राप्त करने के लिए खुली थी। इस योजना ने इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण सुविधाओं (एसईजेड इकाइयों में स्थापित इकाइयों के लिए 20% और गैर-एसईजेड इकाइयों के लिए 25%) के लिए पूंजीगत व्यय में निवेश के लिए सब्सिडी प्रदान की है। भारत में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण में निवेश को बढ़ावा देने में एम-सिप्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

## 2. इलेक्ट्रॉनिक संघटकों और अर्धचालकों के विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए योजना (एसपीईसीएस)

2.1 यह देने का प्रस्ताव है कि वस्तुओं के विनिर्माण के लिए पूंजीगत व्यय के 25% का वित्तीय प्रोत्साहन सूची के अनुसार सूचीबद्ध कर लिया है कि इलेक्ट्रॉनिक घटक और अर्धचालक (एसपीईसीएस) के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना के तहत एक इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला का गठन करना है।

## 3. उद्देश्य

3.1 यह योजना देश में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए घटकों और अर्धचालकों के घरेलू विनिर्माण हेतु असमर्थता को दूर करने में मदद करेगी।

## 4. पात्रता

4.1 एसपीईसीएस नई इकाइयों में निवेश के साथ-साथ मौजूदा इकाइयों की क्षमता/आधुनिकीकरण और विविधीकरण के विस्तार पर लागू होंगे।

## 5. थ्रेसहोल्ड लिमिट

5.1 योजना के तहत पात्र होने के लिए न्यूनतम सीमा का निवेश किया गया है।

5.2 नई इकाइयों या मौजूदा इकाइयों की क्षमता/आधुनिकीकरण और विविधीकरण के विस्तार के लिए सीमाएं समान हैं।

5.3 समय-समय पर परिवर्तन, यदि कोई हो, सामान/थ्रेसहोल्ड की सूची के संबंध में समीक्षा की जाएगी, जिसके लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

## 6. योजना का कार्यकाल

6.1 विनिर्देश इसके अधिसूचना की तारीख से 3 वर्षों के लिए शुरू में खुलेगा। योजना के तहत प्राप्त आवेदनों को सतत आधार पर अनुमोदित किया जाएगा और योजना के तहत स्वीकृत अनुमोदन के अनुसार कार्यान्वयन जारी रहेगा।

## 7. योजना के तहत प्रोत्साहन

7.1 पूंजीगत व्यय पर 25% का प्रोत्साहन वस्तुओं के लिए निवेश करने वाली इकाइयों को सूची के अनुसार प्रदान किया जाएगा। प्रोत्साहन प्रतिपूर्ति के आधार पर प्रदान किया जाएगा।

7.2 पूंजी व्यय संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, संबद्ध उपयोगिताओं और प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) के लिए सहित कुल खर्च होगा। ऐसे पात्र पूंजीगत व्यय का विवरण दिशानिर्देशों में शामिल किए जाएंगे। फर्बिंशड प्लांट, मशीनरी और उपकरण (संबंधित उपयोगिताओं और आरएंडडी के लिए) सहित कुल मूल्य, चाहे आयातित हों या घरेलू रूप से खरीदे गए हों, कुल योग्य संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों के 20% से अधिक होने पर नहीं (संबद्ध उपयोगिताओं और आर एंड डी सहित) इस संबंध में प्रोत्साहन की गणना पर विचार किए जाएंगे।

7.3 प्रोत्साहन, यदि कोई हो, राज्य सरकार या उसकी किसी भी एजेंसी या स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तावित योजना के तहत प्रोत्साहन पात्रता से अधिक और उससे अधिक होगा।

7.4 आवेदक भारत सरकार की किसी अन्य योजना के तहत लाभ लेने के लिए भी पात्र होंगे। हालांकि, एम-सिप्स योजना के तहत आवेदकों द्वारा किए गए निवेश, जिनके लिए प्रोत्साहन का दावा किया गया है, विशेष स्कीम के तहत योग्य निवेश के रूप अर्हता प्राप्त नहीं करेंगे।

## 8. अनुमोदन और संवितरण प्रक्रिया

8.1 योजना के तहत आवेदन भारत में पंजीकृत किसी भी संस्था द्वारा किया जा सकता है।

8.2 प्रत्येक आवेदन को नए निवेश के रूप में माना जाएगा और इसे एक स्वतंत्र अनुप्रयोग के रूप में माना जाएगा। आवेदन केवल एकल चरण की परियोजनाओं के लिए होगा और योजना के तहत चरण-वार आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी आवेदक पर कई आवेदन करने और/या कई स्थानों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है।

8.3 योजना की नियत तारीख से पहले, प्रस्तुत किए गए सभी प्रकार प्रारंभिक आवेदन एक सतत आधार पर अनुमोदित किए जाएंगे और अनुमोदन के लिए विचार किया जाएगा।

8.4 योजना के तहत प्रोत्साहन आवेदन की पावती की तारीख से लागू होगा। आवेदन की प्रारंभिक जांच के बाद पावती जारी की जाएगी। आवेदन की पावती को विनिर्देश के तहत अनुमोदन के रूप में नहीं लिया जाएगा।

8.5 आवेदन की पावती की तारीख से 5 वर्षों के भीतर किए गए निवेश के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध होगा।

8.6 पात्र पूंजीगत व्यय के विरुद्ध प्रोत्साहन आवेदन की मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा, जो पूंजीगत व्यय सीमा से अधिक और वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआती के अधिन होगा। प्रोत्साहन के लिए पिछले दावों को छह-मासिक आधार पर प्रस्तुत किया जा सकता है।

8.7 एसपीईसीएस के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली इकाई को उत्पादन के प्रारंभ होने की तारीख से कम से कम 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए वाणिज्यिक उत्पादन में रहना होगा या अंतिम प्रोत्साहन की प्राप्ति की तारीख से 1 (एक) वर्ष तक, जो भी बाद में हो।

## 9. शासन तंत्र

9.1 इस योजना को एक नोडल एजेंसी के माध्यम से लागू किया जाएगा। नोडल एजेंसी आवेदन का मूल्यांकन करेगी।

9.2 ऐसी नोडल एजेंसी परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के रूप में कार्य करेगी और समय-समय पर एमईआईटीवाई द्वारा सौंपे गए सचिवीय, प्रबंधकीय और कार्यान्वयन सहायता प्रदान करने और अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए

जिम्मेदार होगी। पीएमए की कार्यप्रणाली और जिम्मेदारियों एमईआईटीवाई द्वारा को योजना दिशानिर्देशों में विस्तृत रूपसे जारी किया जाएगा।

9.3 एसपीईसीएस, पीएमए के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियों को करने के लिए, अन्य बातों के साथ साथ निम्न भी होगा :

9.3.1 आवेदन को प्राप्त करें, स्वीकृति जारी करें, मूल्यांकन प्राप्त करें और योजना के तहत समर्थन के लिए आवेदकों की पात्रता सत्यापित करें।

9.3.2 स्वीकृत दावों की जांच करें और स्वीकृत आवेदकों को प्रोत्साहन वितरित करें।

9.3.3 योजना की और प्रगति प्रदर्शन के संबंध में एमईआईटीवाई को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

9.4 पीएमए, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा गठित किए जाने वाली कार्यकारी समिति (ईसी) के समक्ष आंकलित और पात्र पाए गए आवेदनों को पेश करेगा। ईसी की अध्यक्षता एक अधिकारी द्वारा की जाएगी, जो एमईआईटीवाई में संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं हो। चुनाव आयोग में संबंधित मंत्रालयों/विभागों और संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। योजना के दिशानिर्देशों में चुनाव आयोग के विस्तृत संविधान, कार्यप्रणाली और जिम्मेदारियों को विस्तृत किया जाएगा।

9.5 ईसी आवेदनों के अनुमोदन/अस्वीकृति/संशोधन के लिए पीएमए को सिफारिश करेगा। चुनाव आयोग की सिफारिशों के आधार पर, पीएमए आवेदक को अनुमोदन पत्र जारी करेगा, जिसकी प्रतिलिपि एमईआईटीवाई को दी जाएगी।

9.6 एमईआईटीवाई योजना के तहत अनुमोदित परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन के संवितरण के लिए बजटीय प्रावधान करेगा। प्रोत्साहन का संवितरण पीएमए द्वारा अनुमोदन शर्तों और उनके वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाएगा। पीएमए नियमित आधार पर समेकित राशि के रूप में न कि परियोजना-दर-परियोजना के आधार पर एमईआईटीवाई को बजटीय आवश्यकता प्रस्तुत करेगा।

9.7 योजना की प्रगति की समीक्षा एक गवर्निंग काउंसिल (जीसी) के माध्यम से की जाएगी, जिसका गठन एमईआईटीवाई सचिव की अध्यक्षता में एमईआईटीवाई द्वारा किया जाएगा। जीसी में सरकार और उद्योग के विशेषज्ञ शामिल होंगे। जीसी समय-समय पर योजना और उसके बाद की परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेगा। योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर योजना के दिशानिर्देशों में संशोधन करने के लिए जीसी को अधिकृत किया जाएगा। योजना के दिशानिर्देशों में जीसी के विस्तृत संघटन, कार्यप्रणाली और जिम्मेदारियों को विस्तार पूर्वक किया जाएगा।

9.8 योजना के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र वस्तुओं की सूची के साथ, लागू सीमा का, इसकी समीक्षा की जाएगी और समय-समय पर गवर्निंग काउंसिल द्वारा समीक्षा और संशोधन किया जाएगा।

9.9 एसपीईसीएस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, मूल्यांकन और संवितरण दिशानिर्देशों का एक सेट एमईआईटीवाई द्वारा तैयार किया जाएगा और अलग से जारी किया जाएगा।

9.10 योजना का मध्यावधि मूल्यांकन उद्योग और अर्थव्यवस्था द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के संदर्भ में होने वाले लाभों का आकलन करने के लिए किया जाएगा।

सौरभ गौड़, संयुक्त सचिव

अनुबंध

एसपीईसीएस के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र वस्तुओं की सूची

क. आईएनआर 5 करोड़ रुपये की न्यूनतम निवेश सीमा अवधि के साथ वस्तुओं की सूची

क्र.सं.	वस्तुओं का विवरण
1.	एलईडी चिप्स सहित एसएमटी घटक
2.	स्मार्ट कार्ड के लिए चिप मॉड्यूल, आरएफआईडी एंटीना और लेबल, पैकेज में सीओबी/प्रणाली

3.	इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के लिए प्रतिरोधक, कैपेसिटर, फेराइट आदि सहित निष्क्रिय घटक
4.	इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के लिए ट्रांसफॉर्मर, इंडक्टर, कॉइल, रिले, स्विच, माइक्रो मोटर्स, स्टेपर मोटर्स, बीएलडीसी मोटर्स, कनेक्टर्स, हीट सिंक, एंटीना, स्पीकर, माइक्रोफोन आदि सहित विद्युत घटक।
5.	इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के लिए मैग्नेट्रोन, वेव गाइड, सर्कुलेटर्स, कप्लर्स, आइसोलेटर्स, फिल्टर, मैग्नेट, आरएफ घटक
6.	प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी), पीसीबी लैमिनेट, प्रीपेग, फोटोपॉलिमर फिल्मों, पीसीबी प्रिंटिंग स्याही; प्रिंटेड फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स
7.	इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के लिए सेंसर, ट्रांसड्यूसर, एक्चुएटर और क्रिस्टल
8.	कैमरा मॉड्यूल, वाइब्रेटर मोटर/रिंगर
9.	यूएसबी/डेटा केबल, एचडीएमआई केबल्स
10.	विशेष वस्तुओं के अंतर्गत आने वाले सभी सामानों के लिए पूंजीगत सामान

**ख. न्यूनतम 15 करोड़ रुपये की न्यूनतम निवेश सीमा अवधि के साथ वस्तुओं की सूची**

क्र.सं.	वस्तुओं का विवरण
1.	सक्रिय घटक: क. ट्रांजिस्टर, डायोड आदि सहित असतत अर्धचालक उपकरण। ख. एफईटी, एमओएसएफईटी, थाईरिस्टर, आदि सहित पावर अर्धचालक
2.	प्रीफॉर्म ऑफ सिलिका एंड ऑप्टिकल फाइबर
3.	डिस्प्ले असेम्बली एंड टच पैनल/कवर ग्लास असेम्बली

**ग. आईएनआर 25 करोड़ रु. की न्यूनतम निवेश सीमा अवधि के साथ वस्तुओं की सूची**

क्र.सं.	वस्तुओं का विवरण
1.	माइक्रो/नैनो-इलेक्ट्रॉनिक घटक जैसे माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम (एमईएमएस) और नैनो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम (एनईएमएस)
2.	असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) इकाइयाँ

**घ. आईएनआर 75 करोड़ रु. की न्यूनतम निवेश सीमा अवधि के साथ वस्तुओं की सूची**

क्र.सं.	वस्तुओं का विवरण
1.	इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के लिए यांत्रिकी (प्लास्टिक और धातु भागों)

**ड. 250 करोड़ रुपये की न्यूनतम निवेश की सीमा अवधि के साथ वस्तुओं की सूची**

क्र.सं.	वस्तुओं का विवरण
1.	यौगिक अर्धचालकों जैसे जीएएन, एसआईसी, जीएएएस, और सिलिकॉन फोटोनिक्स उपकरणों / इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक घटक

**च. आईएनआर 500 करोड़ रु. की न्यूनतम निवेश की सीमा अवधि के साथ वस्तुओं की सूची**

क्र.सं.	वस्तुओं का विवरण
1.	सेमीकंडक्टर वेफर

**छ. आईएनआर 1,000 करोड़ रु. की निवेश सीमा अवधि के साथ वस्तुओं की सूची**

क्र.सं.	वस्तुओं का विवरण
1.	सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड चिप्स (आईसी) जिसमें लॉजिक [माइक्रोप्रोसेसर, माइक्रोकंट्रोलर, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर (डीएसपी), एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट (एएसआईसी, आदि) मेमोरी; एनालॉग/मिक्स्ड सिग्नल आईसी आदि शामिल हैं ।
2.	इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के लिए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी), लाइट एमिटिंग डायोड (एलईडी), ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड (ओएलईडी), आदि सहित निर्माण इकाइयाँ प्रदर्शित करें ।

**MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY**

(IPHW DIVISION)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st April, 2020

**Subject: Scheme for Promotion of manufacturing of Electronic Components and Semiconductors (SPECS)****1. Background**

**W-18/30/2019-IPHW-MeitY.**—1.1 The Government attaches high priority to electronics hardware manufacturing as it is one of the important pillars of both “Make in India” and “Digital India” programmes of Government of India. Electronics manufacturing industry in India presently faces disability of the order of 8 - 10% compared to competing economies in different segments of electronics manufacturing as well as different stages of the value chain.

1.2 Domestic electronics manufacturing has increased substantially over the last few years and is steadily moving from Semi Knocked Down (SKD) to Completely Knocked Down (CKD) level of manufacturing. However, domestic value addition continues to be low in the range of 10 - 30% only. This is due to the lack of electronic components manufacturing ecosystem, near absence of semiconductor manufacturing ecosystem and absence of display manufacturing ecosystem in the country. Major growth of domestic electronics manufacturing has occurred on account of assembly of finished products from imported electronic components/ sub-assemblies/ parts, mainly catering to the domestic demand.

1.3 Development of supply chain is essential for the manufacturing of electronic products with higher domestic value addition. The vision of National Policy on Electronics 2019 (NPE 2019) notified on 25.02.2019 is to position India as a global hub for Electronics System Design and Manufacturing (ESDM) by encouraging and driving capabilities in the country for developing core components, including chipsets, and creating an enabling environment for the industry to compete globally.

1.4 The manufacturing of electronic components and semiconductors is capital intensive and must deal with constantly changing technology. Components are at the heart of electronic products and constitute a significant part of the total value of Bill of Material (BOM). A vibrant electronic component manufacturing ecosystem is vital for the overall long-term and sustainable growth of electronics manufacturing in India and to achieve net positive Balance of Payments (BoP).

1.5 The main impediments in the way of attracting investments for manufacturing of electronic components/ semiconductors include import at “Nil” Basic Customs Duty (BCD) as most of the electronic components/ semiconductors are covered under the Information Technology Agreement (ITA-1) of WTO; high cost of capital to set up global scale capacities to be competitive; inadequate infrastructure; lack of availability of adequate, reliable and quality power as well as water supply at competitive rates; lack of supply chain; high logistics costs; lack of technology etc.

1.6 The Modified Special Incentive Package Scheme (M-SIPS) was designed as a scheme to provide financial incentives to help to offset the disability and high upfront cost and thereby attract investments in the electronics manufacturing sector. This scheme was open to receive applications till 31.12.2018 for new projects as well as expansion projects. The scheme provided subsidy for investments in capital expenditure for setting up electronics manufacturing facilities (20% for units set up in SEZs units and 25% for non-SEZ units). M-SIPS has played an important role in promoting investments in electronics manufacturing in India.

## **2. Scheme for Promotion of Manufacturing of Electronic Components and Semiconductors (SPECS)**

2.1 It is proposed to offer financial incentive of 25% of capital expenditure for the manufacturing of goods as per list annexed that constitute the supply chain of an electronic product under the Scheme for Promotion of manufacturing of Electronic Components and Semiconductors (SPECS).

### **3. Objective**

3.1 The scheme will help offset the disability for domestic manufacturing of components and semiconductors in order to strengthen the electronics manufacturing ecosystem in the country.

### **4. Eligibility**

4.1 The SPECS will be applicable to investments in new units as well as expansion of capacity/ modernization and diversification of existing units.

### **5. Threshold Limit**

5.1 The minimum threshold investment to be eligible under the scheme is annexed.

5.2 The thresholds are same for new units or expansion of capacity/ modernization and diversification of existing units.

5.3 Periodic reviews will be undertaken with respect to changes, if any, to the list of goods/ thresholds for which incentives are provided.

### **6. Tenure of the Scheme**

6.1 The SPECS will be open for applications initially for 3 years from the date of its notification. The applications received under the scheme will be appraised on an ongoing basis and implementation will continue as per the approvals accorded under the scheme.

### **7. Incentives under the Scheme**

7.1 An incentive of 25% on capital expenditure shall be provided to the units making investment for the goods as per list annexed. The incentive will be provided on reimbursement basis.

7.2 The capital expenditure will be total of expenditure in plant, machinery, equipment, associated utilities and technology, including for Research & Development (R&D). Details of such eligible capital expenditure will be included in the guidelines. The total value of refurbished plant, machinery and equipment (including for associated utilities and R&D), whether imported or domestically procured, not exceeding 20% of the total eligible plant, machinery and equipment (including for associated utilities and R&D), shall be considered for calculation of incentive in this regard.

7.3 The incentives, if any, offered by the State Government or any of its agencies or local bodies shall be over and above the incentive eligible under the proposed scheme.

7.4 The applicants shall also be eligible to take benefit under any other scheme(s) of Government of India. However, investments committed by the applicants under M-SIPS scheme for which incentives have been claimed will not qualify as eligible investments under SPECS scheme.

### **8. Approval and Disbursement Process**

8.1 Application under the scheme can be made by any entity registered in India.

8.2 Each and every application will be treated as new investment and will be treated as an independent application. The application shall be only for single phase projects and phase-wise applications will not be considered under the Scheme. There is no restriction on any applicant from making multiple applications and/ or for multiple locations.

8.3 An initial application completed in all respects and submitted before the due date of the scheme will be appraised on an ongoing basis and considered for approval.

8.4 Incentive under the scheme will be applicable from the date of acknowledgment of the application. Acknowledgment will be issued after initial scrutiny of the application. The acknowledgement of the application shall not be construed as approval under SPECS.

8.5 The incentive will be available for investment made within 5 years from the date of acknowledgement of the application.

8.6 The incentive against the eligible capital expenditure shall be released after the approval of the application, subject to capital expenditure exceeding the threshold value and commencement of commercial production. The subsequent claims for the incentive may be submitted on a six-monthly basis.

8.7 The unit receiving incentive under SPECS will have to remain in commercial production for a period of at least 3 (three) years from the date of commencement of production or 1(one) year from the date of receipt of last incentive, whichever is later.

## 9. Governance Mechanism

9.1 The scheme will be implemented through a nodal agency. The nodal agency would do the assessment of the application.

9.2 Such nodal agency will act as Project Management Agency (PMA) and be responsible for providing secretarial, managerial and implementation support and carrying out other responsibilities as assigned by MeitY from time to time. The functioning and responsibilities of PMA will be elaborated in the Scheme Guidelines to be issued by MeitY separately.

9.3 For carrying out activities related to implementation of SPECS, PMA would inter-alia:

9.3.1 Receive the application, issue acknowledgements, get appraisal done and verify eligibility of the applicants for support under the Scheme.

9.3.2 Get the disbursement claims examined and disburse the incentive to the approved applicants.

9.3.3 Submit periodic reports to MeitY regarding the progress and performance of the Scheme.

9.4 PMA will put the applications that have been appraised and found eligible before the Executive Committee (EC) to be constituted by the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY). EC will be chaired by an officer not below the rank of Joint Secretary in MeitY. EC will comprise of representatives from relevant Ministries/ Departments and organizations. Detailed constitution, functioning and responsibilities of the EC will be elaborated in the Scheme Guidelines.

9.5 EC will recommend to PMA for approval/ rejection / modification of the applications. On the basis of the recommendations of EC, PMA shall issue approval letter to the applicant, with copy to MeitY.

9.6 MeitY shall make budgetary provisions for disbursement of incentives to approved projects under the scheme. The disbursement of the incentives shall be done by the PMA on the basis of approval conditions and as per their financial rules. PMA will submit budgetary requirement to MeitY as consolidated amount on regular basis and not on project-by-project basis.

9.7 The progress of the Scheme will be reviewed through a Governing Council (GC) to be constituted by MeitY under the chairmanship of Secretary, MeitY. GC will comprise of experts from the Government and Industry. GC will periodically review the progress of the Scheme and the projects thereof. GC will be authorised to carry out amendments in the scheme guidelines from time to time for successful implementation of the scheme. Detailed constitution, functioning and responsibilities of the GC will be elaborated in the Scheme Guidelines.

9.8 The list of goods eligible for the incentive under the scheme, along with the applicable thresholds, shall be reviewed and amended from time to time by the Governing Council.

9.9 For effective functioning of the SPECS scheme, a set of Appraisal and Disbursement guidelines shall be drawn up by MeitY and issued separately.

9.10 Mid-term assessment of the scheme shall be done to assess the benefits reaped by the industry and economy in terms of the stated objectives.

SAURABH GAUR, Jt. Secy.

**Annexure**

### **List of Goods eligible for Incentive under SPECS**

#### **A. List of goods with Minimum Investment Threshold Limit of INR 5 crore**

Sl. No.	Description of Goods
1.	SMT components including LED Chips
2.	Chip Modules for Smart Cards, RFID Antenna & Labels, CoB/ System in Package



3.	Passive components including resistors, capacitors, ferrites, etc. for electronic applications
4.	Electromechanical components including transformers, inductors, coils, relays, switches, micro motors, stepper motors, BLDC Motors, Connectors, Heat Sinks, Antenna, Speakers, Microphones, etc. for electronic applications
5.	Magnetrons, Wave guides, Circulators, Couplers, Isolators, Filters, Magnets, RF Components for electronic applications
6.	Printed Circuit Boards (PCBs), PCB Laminates, Prepegs, Photopolymer films, PCB Printing Inks; Printed Flexible Electronics
7.	Sensors, Transducers, Actuators and Crystals for electronic applications
8.	Camera Modules, Vibrator motor/ ringer
9.	USB/Data Cables, HDMI Cables
10.	Capital goods for all the goods covered under SPECS

**B. List of goods with Minimum Investment Threshold limit of INR 15 crore**

Sl. No.	Description of Goods
1.	Active Components: a. Discrete semiconductor devices including transistors, diodes, etc. b. Power semiconductors including FETs, MOSFETs, Thyristors, etc.
2.	Preform of Silica and Optical Fiber
3.	Display Assembly and Touch Panel/ Cover Glass Assembly

**C. List of goods with Minimum Investment Threshold Limit of INR 25 crore**

Sl. No.	Description of Goods
1.	Micro/Nano-electronic components such as Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) and Nano Electro Mechanical Systems (NEMS)
2.	Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP) units

**D. List of goods with Minimum Investment Threshold Limit of INR 75 crore**

Sl. No.	Description of Goods
1.	Mechanics (plastic and metal parts) for electronic applications

**E. List of goods with Minimum Investment Threshold Limit of INR 250 crore**

Sl. No.	Description of Goods
1.	Compound Semiconductors such as GaN, SiC, GaAs, etc. and Silicon Photonics devices/ Integrated Circuits, Optoelectronic components

**F. List of goods with Minimum Investment Threshold Limit of INR 500 crore**

Sl. No.	Description of Goods
1.	Semiconductor Wafers

**G. List of goods with Minimum Investment Threshold Limit of INR 1,000 crore**

Sl. No.	Description of Goods
1.	Semiconductor Integrated Chips (ICs) including Logic [Microprocessor, Microcontrollers, Digital Signal Processors (DSP), Application Specific Integrated Circuits (ASICs), etc.]; Memory; Analog/Mixed Signal ICs, etc.
2.	Display fabrication units including Liquid Crystal Displays (LCD), Light Emitting Diode (LED), Organic Light Emitting Diode (OLED), etc. for electronic applications